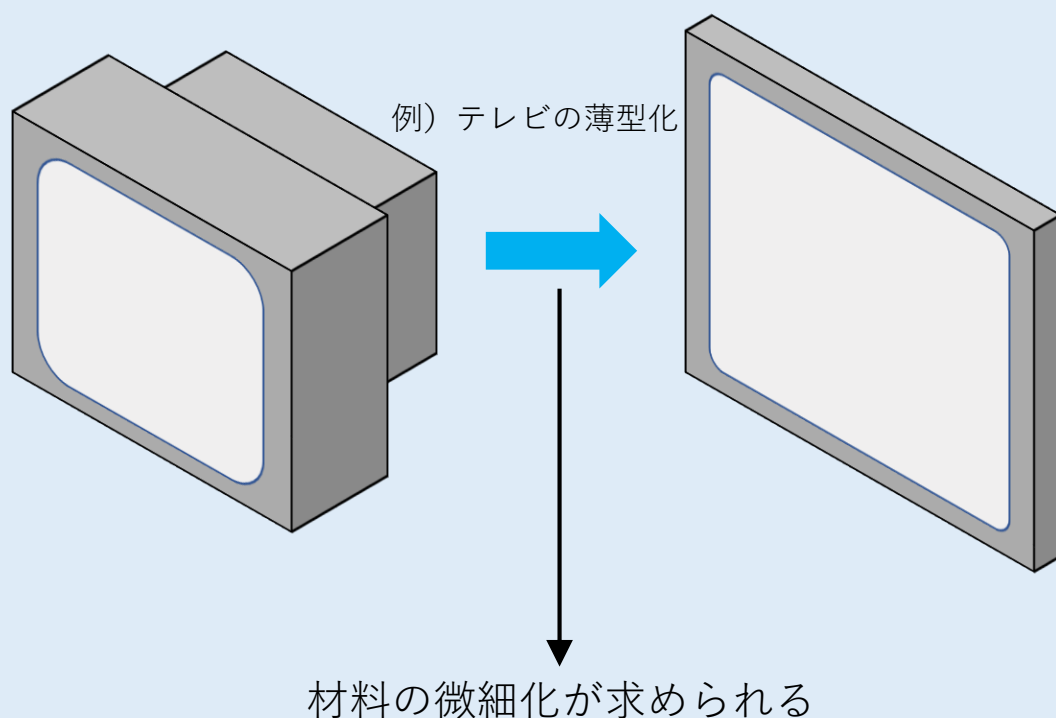


シリーズ：金属マイクロ配線の物性値評価

概要

近年ではデバイスの小型化（薄型化）が進んでおり、それに応じて材料の微細化が求められている。ところが微細な金属は高密度な電流によって発生するジュール熱による溶断を引き起こす懸念がある。これらの障害に対し、独自のFEM解析手法により設計の最適解を提供する。



特に金属マイクロ配線は大型タッチパネル実現化などに寄与する可能性を秘めている一方で高密度な電流によって発生するジュール熱による溶断の懸念がある

このような障害に対して物性値評価は重要であり、これに基づく独自のFEM解析手法により設計の最適解を提供する